

SSD

整机动向

- 加速云服务化
企业用途
HDD→SSD并用化
- 瞬间降低对策
需要SSD的备份

电源电路的动向

- 增加数据保护需求
 - 增加企业用途
- SSD备份用途
<课题>
*耐回流性
⇒以导电性零部件解决

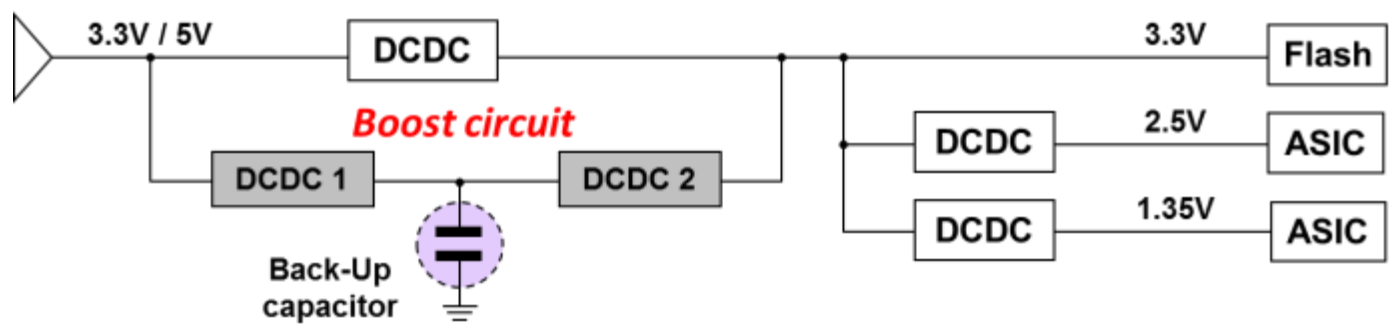
电容器 要求规格

- 大容量
- 低外形
- 小型化
- 高耐压

推荐商品特长

- POSCAP**
- 大容量
 - 低外形 (1.5mm~)
 - 高耐压 (~35V)
- SP-Cap**
- 低外形 (1.2mm~)

电路事例



<推荐项目>

额定	POSCAP	SP-Cap
6.3V	6.3V470uF (D1.5mm)	6.3V220uF (D2mm)
16V	16V100uF (D2mm) 16V150uF (D2mm) 16V150uF (D3mm)	-

额定	POSCAP	SP-Cap
20V	20V100uF (D3mm)	-
25V	25V68uF (D3mm)	-
35V	35V15uF (D2mm)	-